

鋁線打線機

Wire Bonder

系統簡介:

Bonding Wire 即是半導體中被使用來連接晶片電極和 package lead 電極的金屬線，而可以完成這項技術的儀器則稱為鋁線機或打線機。本中心南區實驗室所提供之鋁線鋁線機是利用超音波高頻率振動，產生相對摩擦振動能量，對非鐵金屬、異種金屬合金等材質，使熔接面分子搓合黏固，使用非熔化而牢固接合的方式所達到打線的目的。

儀器圖片:



儀器設備型號:

1. SPB-U668 鋁線打線機
-

服務項目:

1. 鋁線打線。
-

注意事項:

1. 若為第一次使用機台，請 E-mail 或電話聯繫劉先生，以提供機台學習服務。
 2. 建議晶片 Pad 大小為 70um x 70um 以上。
-

儀器維護者:

劉先生 (06)2087971#7109 cylu@narlabs.org.tw